

苏州国芯科技股份有限公司

关于自愿披露公司研发的汽车电子 MCU 新产品内部测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3008PT”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

一、新产品的基本情况

公司成功研发的汽车电子MCU新产品CCFC3008PT是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核MCU芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。

该芯片基于40nm eFlash工艺开发和生产，内嵌3个运行频率达到300MHz的运算CPU核，其中包括两个主核和一个锁步核，另外还内嵌一个运行200MHz的控制CPU核；该芯片内嵌一个硬件安全HSM模块，支持AES/Crypto/SM2等国际和国密算法，可以支持安全启动和OTA；该芯片内嵌多种独立的汽车标准通讯接口，主要包括：支持TSN协议10M/100M 以太网接口（1路）、FlexRay（1路）、eSCI（6路，支持LIN和UART）、MCAN(8路)以及对外控制接口eMIOS（64通道）、高效时序处理单元eTPU（64通道）、通用时序处理单元GTM 和串行通讯接口DSPI（4路，支持MSC），该芯片还配置了较大容量的存储空间，其中程序存储Flash最高配置可达4M字节，数据存储最高配置Flash最高可达512K字节，内存空间（SRAM）最高配置可达640K字节，具有ADC（数模转换）控制电路。

本次成功研发的汽车电子MCU新产品CCFC3008PT按照汽车电子Grade1等级、信息安全Evita-Full等级、功能安全ASIL-D等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了该产品的应用覆盖面；该产品的封装形式包括BGA416/BGA292/LQFP216等，可以广泛应用于汽车动力总成、

底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器。目前，该芯片已经给客户送样并开展模组开发和测试。

二、对公司的影响

公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，该产品在开发阶段就受到国内动力总成、底盘控制器、动力电池控制器和高集成度域控制器模组厂商、整机厂商的关注和支持，已有多家客户开展了相应模组及系统软件的前期开发。该款新产品的研发成功进一步丰富了公司的中高端汽车电子 MCU 产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响，有望为解决我国汽车尤其是新能源汽车产业中高端 MCU 芯片“缺芯”问题做出应有的贡献。

三、风险提示

本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作已经在开展进行中。本次公司推出的汽车电子 MCU 芯片新产品 CCFC3008PT 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日